

# 无锡市好达电子股份有限公司

(无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号)



## 关于无锡市好达电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 审核中心意见落实函回复

### 保荐机构（主承销商）



(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

## 上海证券交易所：

根据贵所于 2021 年 11 月 12 日出具的《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（以下简称“《落实函》”）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为无锡市好达电子股份有限公司（以下简称“好达电子”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），会同发行人及发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后，请审核。

1、如无特殊说明，《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函的回复》（以下简称“本回复”）中使用的简称或名词释义与《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。

2、本回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题	黑体
对审核问询函所列问题的回复	宋体
对招股说明书的修改、补充	楷体（加粗）

3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 目 录

目 录 .....	2
<b>问题 1</b> .....	3
<b>问题 2</b> .....	9

## 问题 1

请发行人结合公司滤波器主要用于2G/3G/4G手机的情形,进一步说明公司是否具备进行5G滤波器技术研发并形成产品销售的能力,公司产品未来在5G市场的发展空间,是否面临市场开拓风险。

请保荐机构核查并发表明确意见。

### 【回复】

#### 一、发行人说明

##### (一) 发行人是否具备进行5G滤波器技术研发并形成产品销售的能力

3GPP(3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划, 成立于1998年的电信标准规范制定机构)定义了5G的两大频率范围(Frequency Range, FR):

频率范围	对应频率	备注
FR1 (Sub-6GHz)	450MHz-6GHz	5G 主用频段
FR2 (mmWave, 毫米波)	24.25GHz-52.60GHz	5G 扩展频段

各个国家或地区可以在上述频率范围内选定本国家或地区的5G通信频段。由上表可知,FR1(Sub-6GHz)对应的频率最低仅为450MHz,即5G通信中亦可存在频率较低的频段,在低、中、高频段均可进行部署。

目前5G主用频段为FR1,即Sub-6GHz(450MHz-6GHz)。在Sub-6GHz的频率范围内,5G无线通信产品(手机、小基站等)用滤波器可以分为以下3类:

序号	5G无线通信产品用滤波器种类	主要频段
1	5G通信中需兼容的2G至4G频段用滤波器	Band 1-Band 41
2	5G重耕频段用滤波器	N28、N41
3	仅5G通信频段用滤波器	N77、N78、N79

对于第1、2类滤波器,发行人目前已具备技术研发并形成产品销售的能力;对于第3类滤波器,发行人目前已具备技术研发能力且在小基站领域已形成产品销售能力。具体情况如下:

## 1、5G 通信中需兼容的 2G 至 4G 频段用滤波器

5G 无线通信产品（手机、小基站等）需要满足 2G 至 4G 通信等已有成熟频段的通信需求，故 5G 无线通信产品需使用 2G 至 4G 频段用滤波器。在目前 5G 通信频段较少的情况下，5G 通信中需兼容的 2G 至 4G 频段用滤波器的数量在 5G 无线通信产品用滤波器中仍占有较高比例。

在该类滤波器的技术研发方面，发行人已具备声表面波射频芯片精确仿真技术、声表面波射频芯片前道技术、高功率滤波器制造技术和声表面波射频芯片 CSP、WLP 封装技术等多项核心技术，相关产品的部分关键性能指标的表现上已达到国外领先厂商的产品参数水平，综合性能表现较好。因此，发行人目前已具备 5G 无线通信产品中需兼容的 2G 至 4G 频段用滤波器的技术研发能力。

## 2、5G 重耕频段用滤波器

为满足 5G 信号广域覆盖的需求，5G 通信频段亦在低、中频段进行部署。5G 通信频段存在与 3G、4G 通信频段重叠的情况。我国大陆地区 5G 重耕频段为 N28 和 N41。其中，N28（频率范围为 703-733MHz/758-788MHz）与 3G、4G 通信对应频段 Band 28（频率范围为 703-748MHz/758-803MHz）存在重叠，N41（频率范围为 2515-2675MHz）与 4G 通信对应频段 Band 41（频率范围为 2496-2690MHz）存在重叠。由于滤波器仅对特定频率范围内的信号做选择而不受通讯制式的影响，故发行人部分能够覆盖 N28、N41 频率范围的 Band 28、Band 41 滤波器同时适用于原有 3G、4G 通信频段和 5G 重耕频段。

在该类滤波器的技术研发方面，由于 N28、N41 滤波器与其对应的 Band 28、Band 41 滤波器在部分频率范围上未发生变化，故发行人芯片设计、芯片制造与封装测试的相关核心技术亦可通用。因此，发行人目前已具备 5G 重耕频段用滤波器的技术研发能力。

在上述第 1、2 类滤波器的产品销售方面，仅就手机滤波器而言，报告期内发行人不同通信制式（2G、3G、4G、5G 等）的主要适用频段的收入金额及占移动通讯领域收入比重的具体情况如下：

单位：万元

通信制式	频段	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
2G、3G、4G	Band 5	2,286.95	11.45%	3,738.68	17.35%	2,346.12	22.45%	1,041.69	20.57%
	合计	<b>2,286.95</b>	<b>11.45%</b>	<b>3,738.68</b>	<b>17.35%</b>	<b>2,346.12</b>	<b>22.45%</b>	<b>1,041.69</b>	<b>20.57%</b>
3G、4G	Band 1	1,177.14	5.89%	1,806.85	8.38%	1,869.70	17.89%	877.73	17.33%
	Band 2	1,083.66	5.42%	1,579.93	7.33%	279.34	2.67%	128.70	2.54%
	Band 3	1,319.02	6.60%	1,136.03	5.27%	419.01	4.01%	422.17	8.34%
	Band 8	2,387.13	11.95%	2,917.47	13.54%	2,455.45	23.49%	847.57	16.73%
	Band 39	167.09	0.84%	193.40	0.90%	109.68	1.05%	73.57	1.45%
	双频段滤波器	1,236.25	6.19%	420.38	1.95%	57.00	0.55%	38.50	0.76%
	合计	<b>7,370.30</b>	<b>36.88%</b>	<b>8,054.07</b>	<b>37.37%</b>	<b>5,190.18</b>	<b>49.66%</b>	<b>2,388.24</b>	<b>47.15%</b>
4G	Band 7	776.41	3.89%	1,214.04	5.63%	314.11	3.01%	193.97	3.83%
	Band 20	531.28	2.66%	338.11	1.57%	77.87	0.75%	40.61	0.80%
	Band 40	1,580.81	7.91%	2,795.99	12.97%	968.42	9.27%	671.18	13.25%
	双频段滤波器	1,171.16	5.86%	209.58	0.97%	-	-	-	-
	其他频段	1,276.56	6.39%	992.28	4.60%	497.57	4.76%	148.85	2.94%
	合计	<b>5,336.21</b>	<b>26.71%</b>	<b>5,550.01</b>	<b>25.75%</b>	<b>1,857.96</b>	<b>17.78%</b>	<b>1,054.61</b>	<b>20.82%</b>
4G、5G	Band 28	968.63	4.85%	817.70	3.79%	89.65	0.86%	47.44	0.94%
	Band 41	3,644.05	18.24%	2,952.84	13.70%	967.20	9.25%	532.91	10.52%
	双频段滤波器	375.89	1.88%	437.37	2.03%	-	-	-	-
	合计	<b>4,988.57</b>	<b>24.97%</b>	<b>4,207.90</b>	<b>19.53%</b>	<b>1,056.86</b>	<b>10.11%</b>	<b>580.36</b>	<b>11.46%</b>
总计		<b>19,982.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,550.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,451.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,064.89</b>	<b>100.00%</b>

注：1、由于在同一频段内，不同国家或地区部署的通信制式不同，故存在发行人部分频段产品同时适用于多个通讯制式（主要包括2G、3G、4G、5G）的情形，表中将发行人各频段滤波器按其对应的主流通信制式进行归类；

2、适用4G通信制式的其他频段包括Band 12、Band 13、Band 25、Band 26、Band 32、Band 38、Band 66、Band 71，上述单个频段产品的收入规模较小。

因此，发行人目前已具备5G通信中需兼容的2G至4G频段用滤波器、5G重耕频段用滤波器的产品销售的能力。

### 3、仅5G通信频段用滤波器

目前在Sub-6GHz的频率范围内，仅5G通信用频段主要包括N77、N78和N79，该等频段所对应的频率范围均在3GHz以上。鉴于目前该等频段处于商用

化初期，频谱资源较为充裕，各个频段间隔较大，对带外抑制陡峭程度的要求不高。基于非声学滤波器技术的 LTCC 滤波器能够满足手机移动通讯在 N77、N78 和 N79 频段内的使用需求且成本较低，是目前该等频段内手机滤波器的主流。但未来若因新增频段不断增多而使该等频段间隔逐渐减小，对带外抑制陡峭程度的要求不断提高，声表面波滤波器在带外抑制方面的优势将得到突显。

在该类滤波器的技术研发方面，目前发行人已具备一定的技术储备。发行人系国家重点研发计划“面向 5G 通讯的高性能滤波器材料和器件应用”的项目牵头承担单位（2020 年 11 月至 2022 年 10 月）。国家重点研发计划是针对事关国计民生的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学技术问题，突破国民经济和社会发展主要领域的技术瓶颈。该项目的课题内容之一即设计研制出用于 5G 通信的 N77 滤波器。国家科技部指定由发行人在内的 3 家技术实力较强的国内滤波器制造企业进行牵头申报，在经过答辩和评审后国家科技部最终选定发行人为该国家重点研发计划的牵头承担单位。

在该类滤波器的产品销售方面，发行人已实现适用于 N78 频段的小基站用滤波器量产销售，2018 年至 2021 年 1-6 月相关产品的销售收入分别为 1.25 万元、0.86 万元、260.71 万元和 319.20 万元。

因此，发行人目前已具备 5G 无线通信产品中仅 5G 通信频段用滤波器的技术研发能力，且在小基站领域已形成产品销售能力。

## **（二）发行人产品未来在 5G 市场的发展空间，是否面临市场开拓风险**

### **1、发行人产品未来在 5G 市场具有较大的发展空间**

#### **（1）5G 重耕频段不断增多，发行人现有技术能够完全适配**

随着 5G 商用进程加速，5G 频谱资源需求增加，未来将会有更多的 3G、4G 频段重耕为 5G 频段。根据 3GPP 于 2021 年发布的“38.104”号 5G 标准协议（17.2.0 版本），目前划分为 5G 通信 FR1 的频段数合计为 56 个，其中与 4G 通信 LTE（4G 主流通信模式，覆盖大部分 3G 频段）频段频率范围、双工模式一致的频段数达到 26 个。该等频段中除 N28、N41 以外，其他频段暂未实现规模化商用。

由于上述 5G 频段用滤波器与其对应的 3G、4G 频段用滤波器在频率范围、双工模式上未发生变化，故发行人现有技术能够完全适配未来不断增多的 5G 重耕频段用滤波器。发行人在 2G 至 4G 等成熟频段用滤波器已具有较强的产品竞争力，未来随着更多的 3G、4G 频段重耕为 5G 频段，发行人在 5G 市场内相关产品的市场占有率将进一步提升。

### **(2) 仅 5G 通信频段用滤波器不断增多，发行人已具备一定的技术储备**

目前仅 5G 通信频段主要包括 N77、N78 和 N79，频段数量相对较少。如上文所述，成本较低的 LTCC 滤波器是目前该等频段内手机滤波器的主流，但未来若因新增频段不断增多而使该等频段间隔逐渐减小，在带外抑制方面具有优势的声表面波滤波器将会获得一定的市场空间。同时，随着高频率 5G 通讯频段的不断部署，市场对 IHP-SAW、BAW 等在高频率频段性能表现较好的滤波器的需求亦将持续增长。

目前发行人的储备技术包括声学滤波器仿真技术、高频率滤波器制造技术等。发行人是国家重点研发计划“面向 5G 通讯的高性能滤波器材料和器件应用”的项目牵头承担单位（2020 年 11 月至 2022 年 10 月），该项目的课题内容之一即设计研制出用于 5G 通信的 N77 滤波器。2021 年 1-6 月，发行人“面向 5G 通讯的高性能滤波器材料和器件应用研发项目”已投入 264.73 万元，“体声波滤波器工艺研发项目”已投入 259.51 万元。随着发行人声学滤波器仿真技术、高频率滤波器制造技术的不断发展，发行人将在仅 5G 通信频段用滤波器领域获得较大的市场发展空间。

### **(3) 5G 通信将进一步推动手机滤波器向模组化发展，发行人已进行技术布局**

5G 手机既需要满足 2G 至 4G 通信已有成熟频段的通信需求，也需要具备 5G 通信新增频段的通信能力，因此 5G 手机需配置 2G 至 5G 通信频段所适用的滤波器，单台手机中的滤波器数量将快速提升。同时随着手机其他功能模块的增多与不断小型化，包括滤波器在内的射频前端芯片呈现出模组化集成的发展态势。

目前发行人 WLP 封装的滤波器最小尺寸可达 0.8mm×0.6mm、双工器最小



尺寸可达 1.5mm×1.1mm，能够满足模组化集成的尺寸要求。2021 年 1-6 月，发行人“射频模组研发项目”已投入 761.10 万元。随着发行人在射频模组研发领域投入的不断增加、模组化技术的不断发展，发行人将在 5G 通信时代获得较大的市场发展空间。

综上，发行人产品未来在 5G 市场具有较大的发展空间。

## 2、发行人预计未来面临的 5G 市场开拓风险较小

发行人产品在 2G 至 4G 市场的目标客户主要包括手机终端品牌、ODM 厂商、通讯设备厂商和无线通信模组厂商等。随着 5G 商用化进程逐步推进，上述客户将作为 5G 市场的重要参与方，对应用于 5G 无线通信产品的滤波器亦存在较大的市场需求。

发行人目前已与上述各类型客户的部分知名厂商建立了良好的合作关系，相关产品已通过客户验证并实现量产销售，如手机终端品牌小米、OPPO、华为等，ODM 厂商华勤、闻泰、龙旗等，通讯设备厂商中兴等，以及无线通信模组厂商广和通等。上述客户作为行业知名厂商，对供应商的研发能力、产品质量保证能力、供货响应能力的要求较高，并且导入新供应商的时间周期相对较长。此外，上述客户均为国内终端品牌或生产厂商，基于供应链安全角度考虑，预计未来针对滤波器等射频前端核心芯片供应链的国产化进程将进一步加快。发行人作为兼具芯片设计技术、制造及封测工艺、标准化量产出货能力的国内厂商，与上述客户已建立较为稳定的合作关系，在未来针对上述客户的 5G 市场开拓方面具备一定优势。

目前，在部分 5G 重耕频段（如 N28、N41 等）和部分仅 5G 通信频段（如 N78）方面，发行人产品已经实现量产销售。发行人未来将持续加大研发投入，及时推出满足 5G 市场需求的滤波器产品，在加深与上述客户合作的基础上，进一步开拓其他知名客户。

综上，发行人预计未来面临的 5G 市场开拓风险较小。

## 二、保荐机构核查并发表意见

### （一）核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

- 1、查阅 3GPP 于 2021 年发布的“38.104”号 5G 标准协议（17.2.0 版本）；
- 2、访谈发行人研发人员，了解发行人 5G 无线通信产品（手机、小基站等）用滤波器的分类、不同类型滤波器的适用频段及技术研发能力；
- 3、查阅发行人销售明细表，了解发行人报告期各期不同类型滤波器的销售收入情况；
- 4、查阅发行人承担的国家重点研发计划“面向 5G 通讯的高性能滤波器材料和器件应用”的《项目任务书》、《课题任务书》等相关材料；
- 5、访谈发行人研发人员、销售人员，了解发行人产品未来在 5G 市场的发展空间及是否存在市场开拓风险。

## （二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人具备进行 5G 滤波器技术研发并形成产品销售的能力，发行人产品未来在 5G 市场具有较大的发展空间，预计未来面临的 5G 市场开拓风险较小。

## 问题 2

请发行人结合与村田的专利纠纷中公司涉诉产品的研发过程，进一步说明相关技术来源的合法合规性，发行人涉诉产品是否存在侵犯村田知识产权的情形。

请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。

### 【回复】

#### 一、发行人说明

（一）结合与村田的专利纠纷中公司涉诉产品的研发过程，进一步说明相关技术来源的合法合规性

##### 1、发行人涉诉产品的研发过程

发行人涉诉产品的研发过程与其他声表面波射频芯片（滤波器、双工器、谐振器）的研发过程基本一致，在量产前主要经过芯片仿真设计、样品试制等研发过程。发行人产品主要研发过程及所需研发技术流程、对应的具体研发部门和阶段性成果文件的具体情况如下：

主要研发过程	所需研发技术流程	所需技术的具体内容	具体执行的研发部门	阶段性成果文件
芯片仿真设计	基板设计	运用商用软件，对芯片和外部电学连接的结构与电路部分进行设计	射频电路组	版图文件
	电磁设计	运用商用软件，对滤波器布图、电路互联、封装结构等整体电磁环境进行设计与仿真	产品开发组	HFSS 文件
	IDT 设计*	运用自研仿真设计平台，对滤波器核心部件 IDT（叉指换能器）的膜厚、孔径和周期等相关参数进行仿真设计，该步骤能够很大程度上决定滤波器在插入损耗、带外抑制等关键性能指标上的表现	产品开发组	S 参数文件
	其他设计	对散热、连接结构等热学、力学部分进行设计	产品开发组	HFSS 文件
	实验迭代	结合发行人在样品试制时反馈的实验参数，修正仿真与设计平台的内置常量	产品开发组	性能测试图
样品试制	芯片制造*	优化生产工艺以满足具体滤波器的量产要求	工艺开发组	产品规格书
	封装测试*			

注：\*表示声表面波射频芯片的核心研发技术流程，该等流程的技术水平能够代表不同厂商的核心技术能力。

由上表可知，发行人每款声表面波射频芯片（滤波器、双工器、谐振器）的主要研发过程及所需技术的开发均对应具体执行的研发部门，并在各阶段留存有相应的成果文件。

经访谈 5 款涉诉产品的主要研发人员并核查对应的阶段性成果文件，发行人 5 款涉诉产品相应的研发人员具体情况如下：

主要研发过程	所需研发技术流程	主要研发人员				
		HDFB01R SS-B5	HDDB05A NSS-B11	HDFB07R SS-B5	HDFB08A RSS-B5	HDFB40R SB-B5
芯片仿真设计	滤波器设计	徐彬、王绍安	徐彬、王绍安	徐彬、韦鹏	徐彬、韦鹏	徐彬、王绍安
	实验迭代	王绍安	王绍安	韦鹏	韦鹏	王绍安
样品试制	芯片制造	袁蔚旻	袁蔚旻	袁蔚旻	袁蔚旻	袁蔚旻
	封装测试	梅从祥	梅从祥	梅从祥	梅从祥	梅从祥

## 2、涉案专利所涉技术均不属于发行人的核心研发技术流程，发行人涉诉产

## 品相关技术均为行业通用技术或基于行业公知技术进行二次创新形成

村田所称涉案专利所涉技术与发行人研发技术流程的对应关系如下：

研发主要过程	所需研发技术流程		涉案专利所涉技术与发行人研发技术流程的对应关系				
			HDFB01R SS-B5	HDDB05A NSS-B11	HDFB07R SS-B5	HDFB08A RSS-B5	HDFB40R SB-B5
芯片仿真设计	滤波器设计	基板设计	-	-	-	-	-
		电磁设计	ZL2004100 05583.3	-	ZL2004100 05583.3; ZL2004100 75163.2	ZL2004100 05583.3	ZL2004100 05583.3
		IDT设计*	-	-	-	-	-
		其他设计	-	ZL2012800 47249.7	-	-	-
	实验迭代	-	-	-	-	-	
样品试制	芯片制造*	-	-	-	-	-	
	封装测试*	-	-	-	-	-	

注：\*表示声表面波射频芯片的核心研发技术流程，该等流程的技术水平能够代表不同厂商的核心技术能力。

由上表可知，发行人 5 款涉诉产品对应的 3 项涉案专利分别归属于发行人滤波器设计中的电磁设计和其他设计这 2 个研发技术流程，均不属于发行人的核心研发技术流程。

研发过程中的非核心研发技术流程与滤波器关键性能指标表现的关联度较弱，相关技术难度不高且存在较多的行业通用技术。发行人 5 款涉诉产品的相关技术均为行业公知技术或基于行业公知技术进行二次创新形成，具体情况如下：

涉案专利	涉诉产品型号	发行人使用的相关技术	相关技术性质
ZL200410005583.3	HDFB07RSS-B5、 HDFB40RSB-B5、 HDFB01RSS-B5、 HDFB08ARSS-B5	交叉金属走线间绝缘膜技术	行业通用技术
ZL200410075163.2	HDFB07RSS-B5	增强焊盘电极与芯片间结合力的锯齿状结构技术	基于行业公知技术进行二次创新形成
ZL201280047249.7	HDDB05ANSS-B11	高频并联谐振器改善滤波器右侧阻带技术	行业通用技术

### **(1) 交叉金属走线间绝缘膜技术**

交叉金属走线间绝缘膜技术属于行业通用技术，是一种在各个领域广泛使用的技术常识，也是微电子器件领域内近几十年来一直在用的公知技术。

### **(2) 增强焊盘电极与芯片间结合力的锯齿状结构技术**

增强焊盘电极与芯片间结合力的锯齿状结构技术系发行人基于公知技术进行二次创新形成。

### **(3) 高频并联谐振器改善滤波器右侧阻带技术**

高频并联谐振器改善滤波器右侧阻带技术属于行业通用技术。

综上，结合涉诉产品的主要研发过程，发行人涉案专利所涉技术均不属于发行人的核心研发技术流程，均为行业通用技术或基于行业公知技术进行二次创新形成，相关技术来源合法合规。

## **(二) 发行人涉诉产品是否存在侵犯村田知识产权的情形**

根据上述关于涉诉产品研发过程以及相关技术来源均合法合规的相关论述，并结合外部机构出具的相关意见，发行人产品是否存在侵犯村田知识产权情形的具体分析如下：

### **1、关于发行人涉诉产品是否侵犯村田 ZL200410005583.3 号专利**

发行人已申请豁免披露。

### **2、关于发行人涉诉产品是否侵犯村田 ZL200410075163.2 号专利**

发行人已申请豁免披露。

### **3、关于发行人涉诉产品是否侵犯村田 ZL201280047249.7 号专利**

发行人已申请豁免披露。

## **二、保荐机构及发行人律师核查并发表意见**

### **(一) 核查程序**

针对上述问题，保荐机构及发行人律师主要履行了以下核查程序并取得了相

关证据，具体如下：

- 1、访谈发行人研发总监，了解发行人 5 款涉诉产品的研发过程；
- 2、访谈发行人 5 款涉诉产品的研发人员，查阅相关阶段性成果文件；
- 3、访谈发行人研发总监，了解声表面波射频芯片的核心研发技术流程，了解村田所称涉案专利所涉技术与发行人研发技术流程的对应关系；
- 4、查阅发行人与村田诉讼案件的相关材料（包括不限于起诉状、裁定书、上诉状等）；
- 5、查阅外部机构出具的相关意见；
- 6、查阅发行人出具的相关说明。

## （二）核查意见

经核查，保荐机构及发行人律师认为：

结合发行人涉诉产品的研发过程，发行人涉诉产品的相关技术来源合法合规，并根据外部机构出具的相关意见，发行人涉诉产品未落入村田涉案专利 ZL200410005583.3、和 ZL201280047249.7 的保护范围，未侵犯其知识产权；因发行人与村田的诉讼案件尚在审理中，发行人涉诉产品是否侵犯村田涉案专利最终有待人民法院审理判决。

（本页无正文，为无锡市好达电子股份有限公司《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核中心意见落实函回复》之签章页）

董事长签字：

刘平

无锡市好达电子股份有限公司

2021年11月18日



## 发行人董事长的声明

本人已认真阅读《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核中心意见落实函回复》全部内容，确认回复的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长签字：

  
刘平

无锡市好达电子股份有限公司

2021年11月15日





（本页无正文，为安信证券股份有限公司《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核中心意见落实函回复》之签章页）

保荐代表人（签名）：

  
周鹏翔

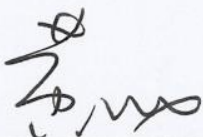
  
王庆坡

  
安信证券股份有限公司  
2021年11月18日

## 落实函回复的声明

本人已认真阅读《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函回复》的全部内容，了解回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，问询函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长（签名）：



黄炎勋

